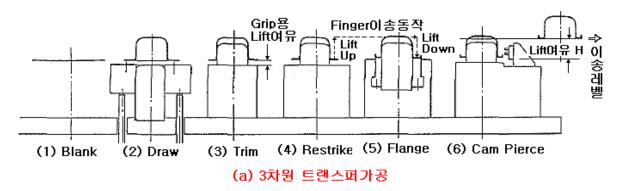
옮김: 육성진

여러 공정을 필요로 하는 부품의 가공법의 하나로 Fig. 2에 나타낸 것처럼 각 공정의 금형을 공정마다 일정한 피치로 배열하고 공정마다 분리된 반송품(제품)을 Fig. 3, 4에 Finger로 일정 피치씩 반송하고, 순차적으로 가공하여 목적으로 하는 성형품을 얻는 가공법을 말한다.

Fig. 2 Transfer Die의 개념도



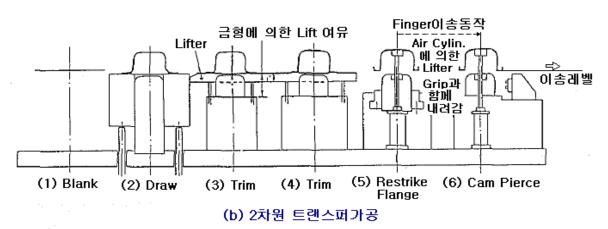


Fig. 3 Finger로 반송품을 Clamp 한 상태도

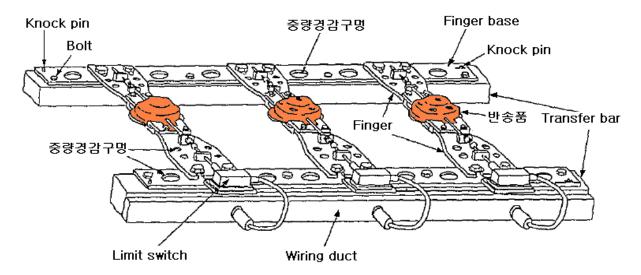


Fig. 4 Transfer 금형과 Finger의 중요부 단면도

